Forward-looking Statement

- Information included in this presentation that are not historical in nature are "forward looking statements ". C Sun cautions readers that forward looking statements are based on C Sun's reasonable knowledge and current expectations and are subject to various risks and uncertainties.

- Actual results may differ materially from those contained in such forward looking statements for a variety of reasons including without limitation, risks associated with demand and supply change, manufacturing and supply capacity, design win, time to market, market competition, industrial cyclicality, customer's financial condition, exchange rate fluctuation, legal actions, amendments of the laws and regulations, global economy change, natural disasters, and other unexpected events which may disrupt C Sun's business and operations.

- Accordingly, readers should not place reliance on any forward looking statements. Except as required by law, C Sun undertakes no obligation to update any forward looking statement, whether as a result of new information, future events, or otherwise.

經營理念
皆大歡喜

G2C+

合力共創 同行致遠

善意的動機 引領事業走向成功

不論是在開創事業，或是在挑戰新任務時，我會先思考：
這是不是對世人有利？是不是利他的行為？
凡是能確信是基於利他、發自「善意動機」的事業，
最後無一例外，都能獲得好結果。

--- 摘自《心》稻盛和夫---

- 公司簡介
- AI西部黃金廊道: 先進封裝閃耀鑽石鏈

  志聖/G2C半導體與先進封裝產業定位

  PLP現況與未來機會
- 東南亞市場拓展
- 營運概況
- 展會快訊

c sun

公司簡介

- 1966年成立，2001年於台灣上市，邁向60週年紀念。
- 2023年榮獲台積電最佳量產支援獎，十年來唯一台灣製程設備公司。
- 從印刷電路板、平板顯示器、IC載板，到先進封裝的製程設備領導者。
- 家族和員工持有超過40%的股份。

G2C+

T STRATEGY ALLIANCE

GPM均豪 | CSUN志聖 | GMM均華

市場第一

貼近領先客戶

技術創新

『管理即整合』 --司徒達賢--

『經營典範的轉移在於：

競爭導向 ➡ 共榮共生

阻絕屏蔽 ➡ 串連相通

產品服務 ➡ 生態系鏈

一己之力 ➡ 借力使力』

--邱奕嘉--

G2C+

T STRATEGY ALLIANCE

聯盟核心技術

聯盟總市值：逾800億台幣
聯盟總人數：1,540
R&D 人數：508
R&D 佔總人數比例：33%

Stock No. 2467.TT

C SUN 志聖

Thermal (熱)
UV (光)
Lamination/Bonder (貼膜/壓合)
Peeling (撕膜)
Plasma (電漿清潔)

5443.TT

GPM 均豪精密

AOI (光學檢測)
Grinding (研磨)
Automation (智動化)

6640.TT

GMM 均華精密

Pick and Place (精密取放)
Die Bonder (黏晶機)
Chip Sorter (分揀機)
Laser Mark (雷射打印)

西部黃金廊道 鑽石鏈

AI西部走廊:

先進封裝的閃耀鑽石鏈

77.9%

台灣**晶圓製造**
全球產值市佔率

台灣**封裝測試**
全球產值市佔率

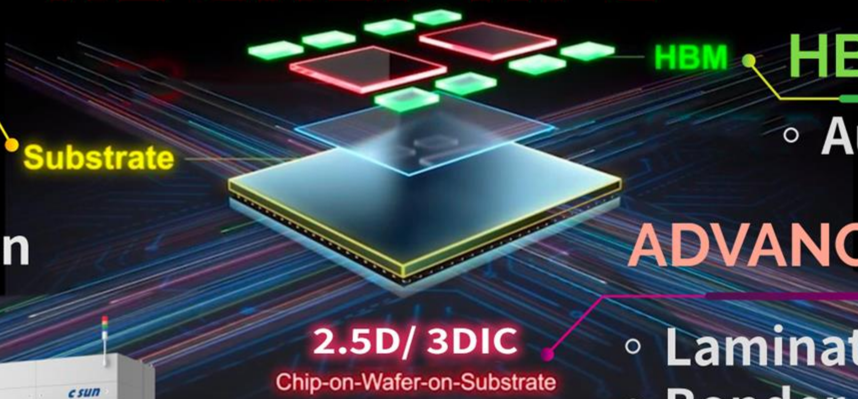
52.6%

c sun


tsmc
2023
EXCELLENT PERFORMANCE AWARD
In Recognition
Of
Excellent Production Support
To
c sun志聖
C SUN MFG., LTD
Chief Executive Officer
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Ltd.
c sun

SPANNING THE AI INDUSTRY

AI CHIP HPC



IC SUBSTRATE

- Lamination
- Vacuum Lamination
- ABF Peeler

HBM PACKAGING

- Auto Oven

ADVANCED PACKAGING

- Lamination
- Bonder
- Auto Oven
- UV Cure

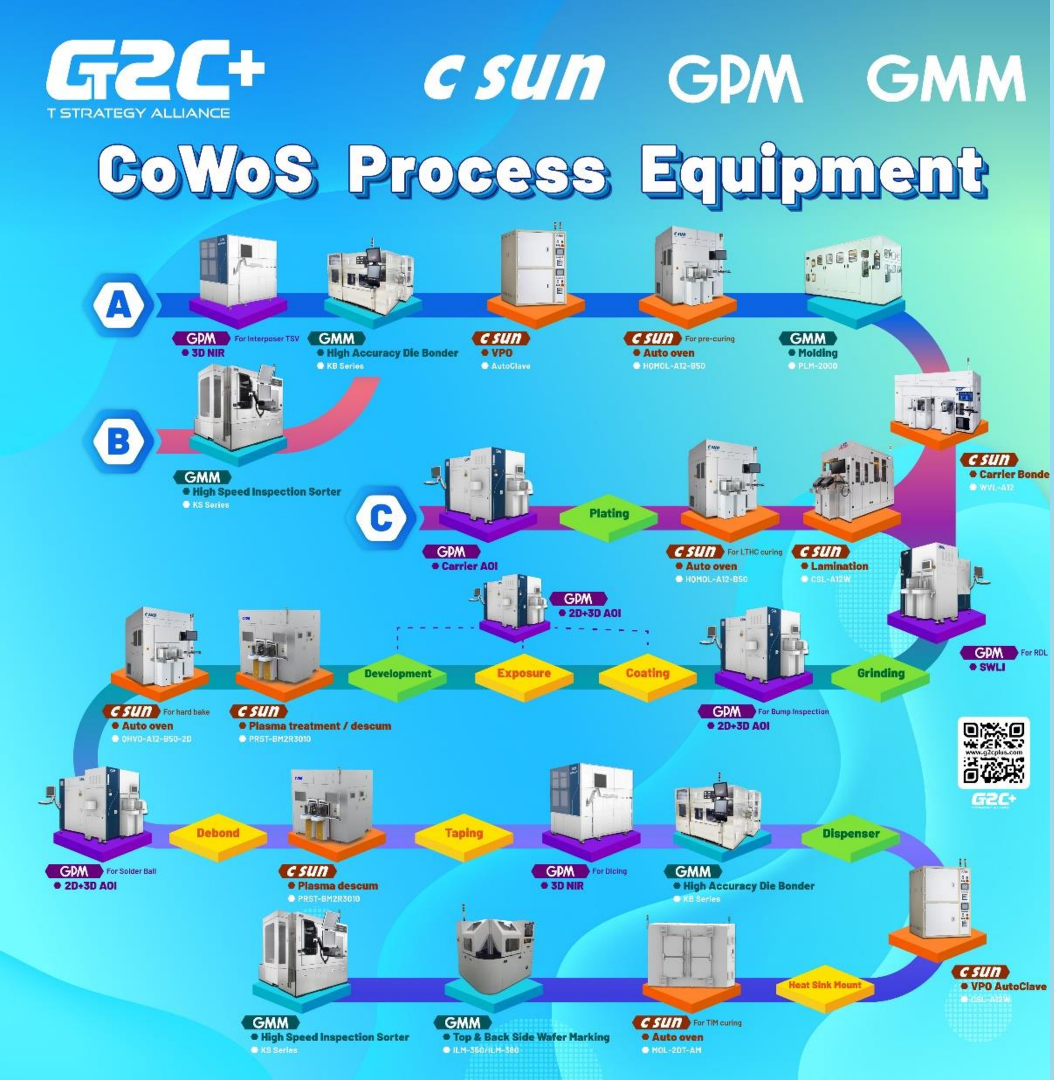
晶圓大廠
向下整合

Foundry + Advanced Packaging + Testing
(InFo、CoWoS、SoIC)

先進封裝
Advanced Packaging

Flip Chip > Fan out >2.5D/3D + Testing
(SiP、PoP、McM、FoCoS)

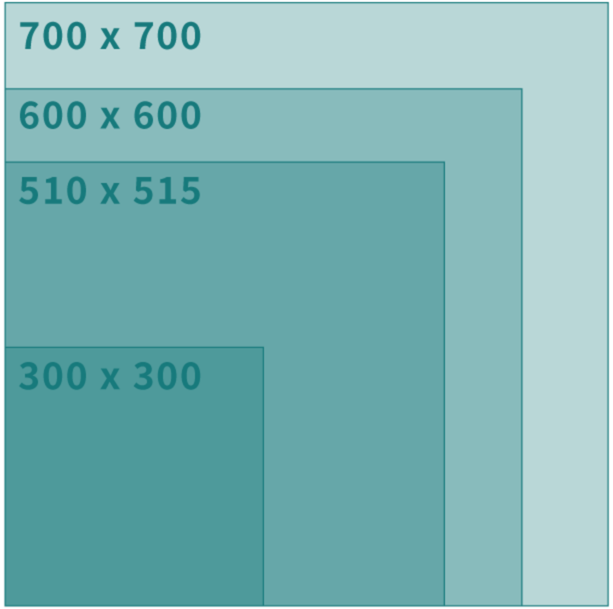
OSAT
向上發展



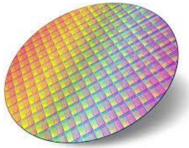
G2C+ CoWoS One Stop Solution

PLP現況與機會

Glass/Metal 對應基材



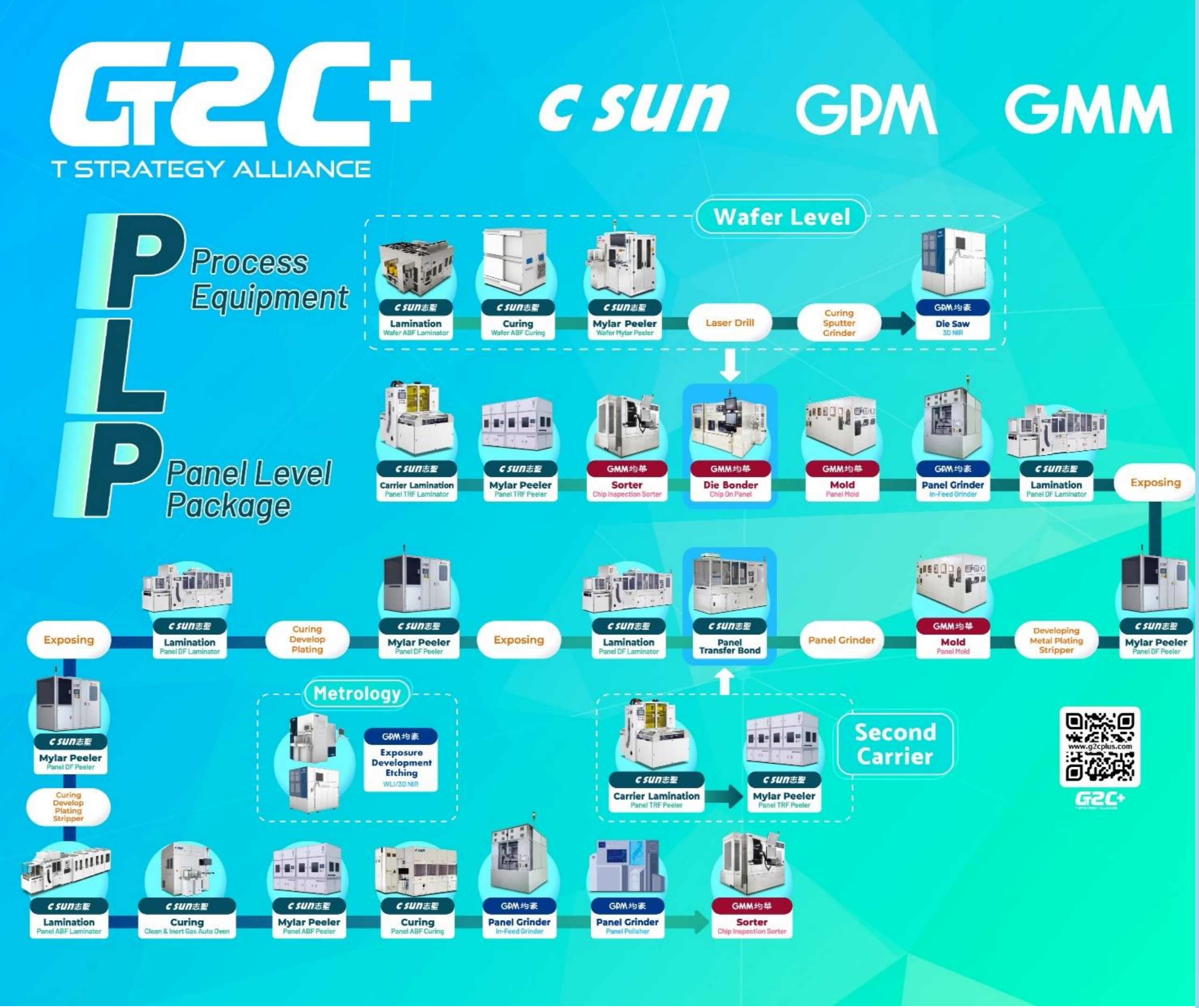
未來應用:



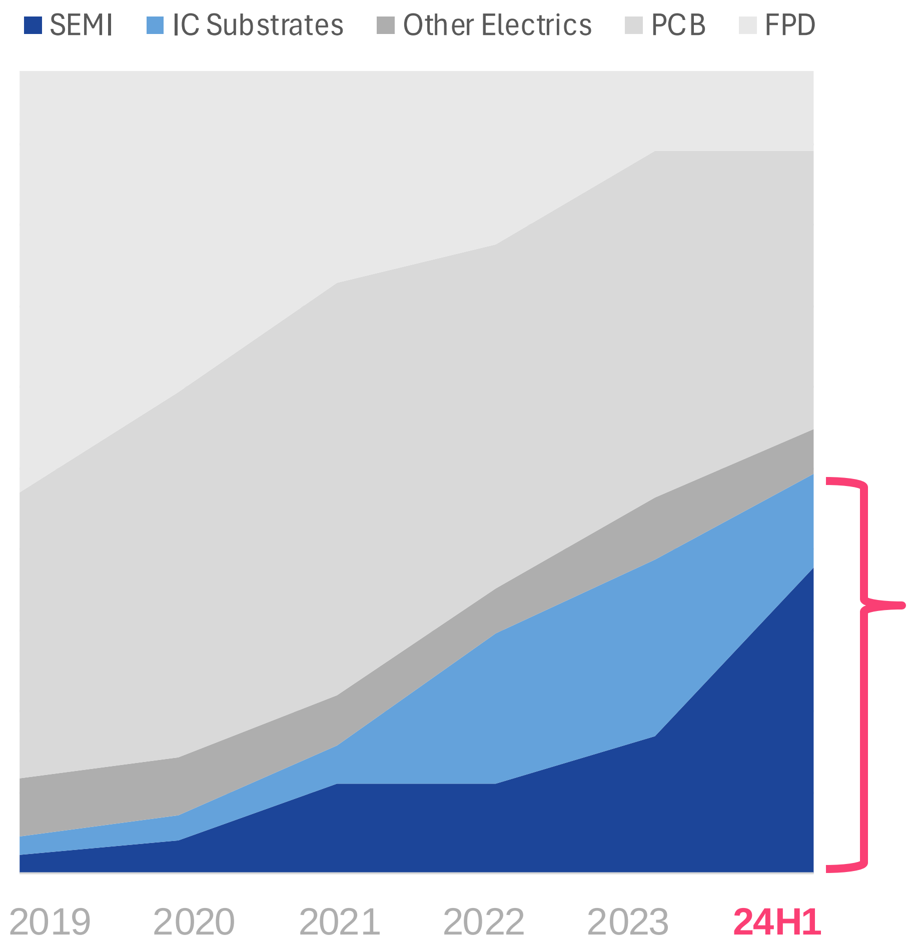
AI晶片

現況應用:

PMIC、RF



G2C+ PLP One Stop Solution



2024H1
營收產業分類

~51%
來自SEMI與PCB先進製程佔比

東南亞
市場開發

東南亞市場拓展

泰國

IDM自有封測服務：

恩智浦

安森美

印刷電路板製造：

欣興、耀華

泰鼎、定穎

敬鵬、臻鼎

金像、滬電

四會富仕

中富、奧士康

中京、建滔

威爾高、澳弘

華通

CMK、KCE

馬來西亞

IDM 自有封測服務：

德州儀器

恩智浦

英飛淩

意法半導體

瑞薩電子

安森美

美光

英特爾

委外封裝測試服務：

日月光

功率元件製造：

ROHM

新加坡

晶圓代工服務：

SSMC

聯電

格羅方德

世界先進

記憶體製造：

美光

委外封裝測試服務：

日月光

艾克爾

財務
概況

財務簡表

in TWD millions

	2024H1	%	2023H1	%	2023	%	2022	%	2021	%	2020	%	2019	%
Revenue-Consolidated	2,429		1,696		3,626		5,367		5,723		4,086		4,438	
COGS	1,450	59.7%	1,053	62.1%	2,120	58.5%	3,459	64.4%	3,781	66.1%	2,538	62.1%	3,170	71.4%
Gross Margin	980	40.3%	643	37.9%	1,506	41.5%	1,908	35.6%	1,942	33.9%	1,547	37.9%	1,268	28.6%
Operating Expense	648	26.7%	460	27.2%	1,104	30.4%	1,178	22.0%	1,202	21.0%	1,017	24.9%	954	21.5%
Operating Income	332	13.7%	182	10.8%	403	11.1%	730	13.6%	740	12.9%	531	13.0%	314	7.1%
Net Non-Op. Profit	150	6.2%	51	3.0%	181	5.0%	231	4.3%	135	2.4%	75	1.8%	104	2.3%
Net Income before tax	482	19.8%	233	13.8%	584	16.1%	961	17.9%	875	15.3%	606	14.8%	418	9.4%
Net Income after tax	377	15.5%	220	13.0%	530	14.6%	783	14.6%	716	12.5%	475	11.6%	338	7.6%
Attribute to stockholder's of the parent	359	14.8%	207	12.2%	486	13.4%	719	13.4%	660	11.5%	439	10.7%	312	7.0%
ROE	8.85%		6.09%		14.11%		22.03%		23.04%		16.46%		11.64%	
EPS (NT$/after tax)	$2.40		$1.32		$3.12		$4.59		$4.35		$2.94		$2.09	
Debt Ratio	52.48%		56.47%		57.34%		57.52%		58.44%		60.26%		58.66%	

G2C+

合力共創 同行致遠

歡迎蒞臨志聖 2024展會現場

10/23~10/25 TPCA SHOW

The Largest Booth in 2024 SEMICON Taiwan